

### Informations de base

**2018/2947(DEA)**

DEA - Procédure d'acte délégué

Exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée

Complétant [2008/0240\(COD\)](#)

**Subject**

3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique  
3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)

Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur

### Informations complémentaires

Source	Document	Date
Commission européenne	<a href="#">EUR-Lex</a>	